

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2023年11月2日(02.11.2023)



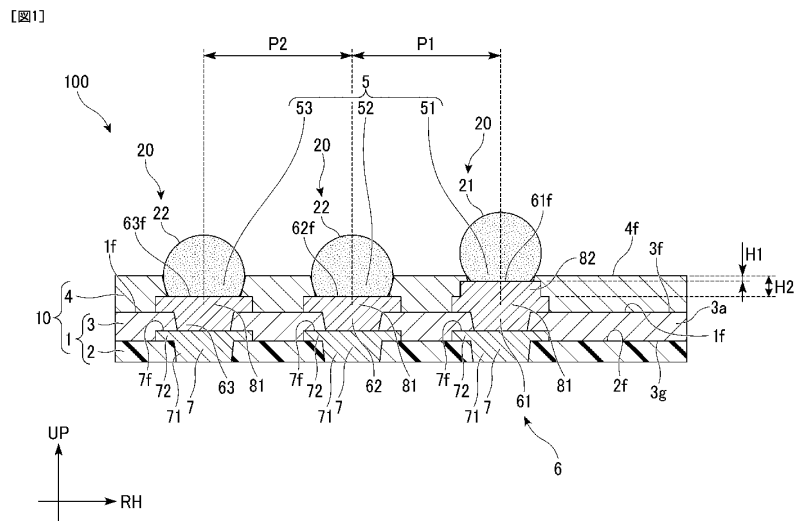
(10) 国際公開番号

**WO 2023/210815 A1**

- (51) 国際特許分類:  
*H01L 23/12* (2006.01) *H05K 1/02* (2006.01)  
*H01L 25/04* (2023.01) *H05K 3/34* (2006.01)  
*H01L 25/18* (2023.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/016877
- (22) 国際出願日: 2023年4月28日(28.04.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2022-075341 2022年4月28日(28.04.2022) JP
- (71) 出願人: 凸版印刷株式会社 (TOPPAN INC.)  
[JP/JP]; 〒1100016 東京都台東区台東 1 丁目 5 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 菅原 賢太 (SUGAWARA Kenta);  
〒1100016 東京都台東区台東 1 丁目 5 番 1 号 凸版印刷株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 松沼 泰史, 外 (MATSUNUMA Yasushi et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内 1 丁目 9 番 2 号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

(54) Title: WIRING BOARD, SEMICONDUCTOR DEVICE, AND METHOD FOR PRODUCING WIRING BOARD

(54) 発明の名称: 配線基板、半導体装置及び配線基板の製造方法



(57) Abstract: The present invention is a wiring board (100) having a multilayer structure, the wiring board (100) having a plurality of buildup layers (1), wherein a surface-side buildup layer (3) formed last from among the buildup layers (1) has a first solder pad (61) and a second solder pad (62), a solder resist layer (4) is provided to the surface side of the surface-side buildup layer (3), and the heights from the surfaces of each of the first solder pad (61) and the second solder pad (62) to the surface of the solder resist layer (4) are different from one another.

[続葉有]

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH,  
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,  
MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ,  
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,  
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,  
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

---

(57) 要約: 本発明は、複数のビルドアップ層 (1) を有する多層構造の配線基板 (100) であって、ビルドアップ層 (1) のうち、最後に形成された表面側のビルドアップ層 (3) が第一はんだパッド (61) 及び第二はんだパッド (62) を有し、表面側のビルドアップ層 (3) の表面側に溶剤レジスト層 (4) を有し、第一はんだパッド (61) 及び第二はんだパッド (62) のそれぞれの表面から溶剤レジスト層 (4) の表面までの高さが、異なる、配線基板 (100) である。